证券代码：688486 证券简称：龙迅股份

**龙迅半导体（合肥）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

（2025年5月13日—5月14日）

编号：LT2025-007

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  ■现场参观 ■其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华泰资产、西部证券、银华基金、东证自营、财通资管、青骊投资、建信基金、华西基金、华源证券、兴银基金、远舟资本、正圆投资、北京星石、丹羿投资、天风证券、财通基金、永赢基金 |
| 时间 | 2025年5月13日—5月14日 |
| 地点 | 公司会议室、线上电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：赵彧女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **交流的主要问题及回复**  **问题1：请介绍一下公司一季度研发投入增加的原因？**  **回复：**公司2025年1季度研发投入2,759.14万元，占营业收入的比重为25.31%，同比增长23.24%。主要系报告期内研发人员增加及薪酬提高所致。  **问题2：请介绍一下公司研发团队的情况？**  **回复：**截至2024年底，公司研发人员176名，占总人数的72.73%，其中硕士以上学历占研发总人数的51.14%。2025年度，公司将持续加大研发投入和提升研发平台硬件设施水平，多举措壮大研发团队，优化组织架构，积极探索国际化人才战略，增强研发队伍实力，有针对性的围绕高性能计算、汽车电子等业务方向进行人才储备。  **问题3：请介绍一下公司2025年的研发计划？**  **回复：**2025年度，公司将持续聚焦前沿技术，突破核心技术瓶颈，跟踪并布局更高的芯片工艺，提升芯片性能、降低产品功耗；构建统一的芯片设计平台，优化IP复用，提高研发效率和质量；同时在车载、HPC、微显示芯片等领域加大研发投入，提升新产品的市场份额；加强技术方面的国际合作，促进设计和测试等环节的高效对接，缩短产品上市周期，提高研发响应速度。 |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年5月15日 |